

2026年5月7日

各位

会社名 F I G 株式会社
代表者名 代表取締役社長 村井 雄司
(コード：4392 東証プライム 福証)
問合せ先 取締役常務執行役員 岐部 和久
(TEL. 097-576-8730)

半導体先進パッケージ IC テスト用自動化装置の開発に関するお知らせ

当社グループのREALIZE株式会社は、このたび台湾企業と共同で、世界的半導体メーカー向け最先端AI半導体の検査工程に使用される自動化装置を開発いたしましたので、お知らせいたします。

本装置は、グローバル市場において高いシェアを有する米国企業のAI向け半導体に搭載されるGPUパッケージを対象としており、品質および信頼性を評価する量産工程において使用されるものです。当該工程では、微細かつ高価な半導体パッケージの着脱を繰り返し行う必要があることから、高度な位置決め精度、安定した動作性能、ならびに長時間連続稼働に耐え得る高い信頼性が求められます。

今回開発した自動化装置は、これらの厳しい要求に対応し、作業負荷の低減と品質の安定化を同時に実現するものであり、AI向け高性能半導体の量産を支える重要工程において、当社グループの高精度制御技術および安定稼働に関する豊富な実績が評価されたものと認識しております。

AI半導体市場は、生成AIの急速な普及を背景として今後も高い成長が見込まれており、当社グループは本分野を重要な成長領域の一つと位置付けております。今回の開発を契機として、半導体製造分野における自動化・省人化ニーズへの対応を一層強化するとともに、次世代技術を支える製造現場の高度化に貢献してまいります。

【本件のお問い合わせ】

REALIZE株式会社

TEL : 097-544-1001

お問合せフォームはこちら <https://www.realize-fig.jp/contact/>

以上